

技术动态

10

解决方案精选

ADF7023-J:GMSK收发器解决方案 12

DAC1008D750:双路750Mpsps数模转换方案 16

SX1231:低功耗UHF RF收发器解决方案 18

TWR-WIFI-G1011MI:802.11b Wi-Fi 解决方案 21

CY3664-enCoRe III:
无线鼠标游戏手柄开发系统解决方案 25

全球IC新品指南

月度新品总汇 28

无线通信

波束成形系统的相位测量 39

电子百科

42

在线座谈精华

从软件无线电技术到无线网络云 43

设计应用

基于Cyclone III FPGA的DDR2接口设计分析 48

基于S7-300PLC的城市污水处理工艺流程
控制系统设计 52飞思卡尔DSP系列为下一代无线基站部署
提供更高的性能支持 56

《世界电子元器件》(GEC)

以新产品为核心,介绍世界最新型
电子元器件,推广先进设计应用技
术,引导元器件产品的市场需求。

业界访谈

创新带来变革 58

赛灵思推出可扩展处理平台 Zynq-7000系列 59

打造工程师心目中的理想MCU 60

专注三大领域,
TransSwitch计划实现5年高速增长 63

用你的创意点亮未来的生活 64

创锐讯10G EPON解决方案提升其在
FTTx市场中的地位 66

意法半导体聚焦三网融合,倡导数字娱乐新体验 67

博通——多方合作,满足“三网融合”新需求 68

泰鼎——高举“三网融合”大旗,
大力发展NGB产品 69

Picochip推出下一代家用基站SoC 70

GLOBAL ELECTRONICS CHINA